

05.2;09

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УДАРНОЙ ИОНИЗАЦИИ В ТОНКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНКАХ ДЛЯ МОДУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КОРОТКОВОЛНОВОЙ ЧАСТИ СВЧ ДИАПАЗОНА

© Л.И.Кац, В.Н.Чупис, А.Ю.Сомов, Е.М.Семенова

Построение эффективных полупроводниковых модуляторов и ограничителей на высокие уровни мощности в КВЧ (крайне высокочастотном) диапазоне — одна из важных проблем развития и освоения коротковолновой части СВЧ диапазона. Исследования в этой области стимулируют поиск новых физических эффектов взаимодействия КВЧ излучения с полупроводниковой плазмой.

Одна из основных проблем создания эффективных управляющих приборов в КВЧ диапазоне в данном случае состоит в необходимости учета двух трудно сочетаемых условий — минимальности вносимого ослабления и достижения высокого уровня ограничения во "включенном", рабочем состоянии. По этой причине значительный интерес представляет исследование эффектов взаимодействия коротковолнового излучения с неравновесной ионизированной плазмой в тонких полупроводниках и полупроводниковых пленках [1]. Стационарная ударная ионизация в полупроводниках, как показывают результаты исследований [2–3], позволяет эффективно управлять параметрами СВЧ излучения в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах.

В этом направлении наибольший интерес представляют исследование взаимодействия электромагнитной волны с пространственно неоднородной плазмой в тонких, с толщиной, меньшей характерной диффузационной длины, полупроводниковых пленках [4]. Объемное распределение ионизированных носителей в таких полупроводниках существенным образом связано с особенностями возбуждения неравновесной плазмы в тонких полупроводниках (влиянием поверхности на набор электронами энергии ионизации и явлением поверхностной рекомбинации) и позволяет в широких пределах управлять отражательными характеристиками ионизированных полупроводниковых пленок в КВЧ диапазоне [1].

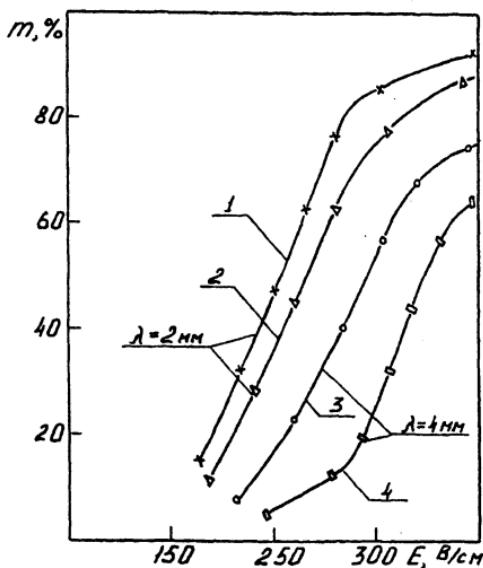


Рис. 1. Зависимости коэффициента глубины модуляции от напряженности ионизирующего электрического поля: 1, 3 — $d = 100 \text{ мкм}$; 2, 4 — $d = 50 \text{ мкм}$.

Эти данные послужили основанием для проведения эксперимента по импульсной модуляции коротковолнового излучения с длиной волны $\lambda = 2 \text{ мм}$ и $\lambda = 4 \text{ мм}$ с помощью эффекта ударной ионизации. В экспериментах использовались полупроводниковые образцы $n\text{-InSb}$ ($n = 2.8 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$, $\mu = 5 \cdot 10^5 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$) с толщиной (d) 50 и 100 мкм.

Полупроводниковая пластина на диэлектрической подложке располагалась в стандартном волноводном тракте перпендикулярно к оси волновода. Волноводная секция с полупроводником, находящимся при температуре жидкого азота, помещалась между полюсами магнита. На полупроводниковый образец, перекрывающий стандартный волновод сечением $S = 1.2 \cdot 2.4 \text{ мм}^2$ ($\lambda = 2 \text{ мм}$) подавались импульсы тока (длительностью $\tau_u = 1 \text{ мкс}$ при скважности $Q = 1000$), обеспечивающие напряженность электрического поля в полупроводнике до $350 \text{ В}/\text{см}$, при $T = 77 \text{ К}$.

Оценки изменения температуры решетки при импульсном электрическом воздействии, проведенные в соответствии с работой [5], показали, что при $E = 100 \text{ В}/\text{см}$ ($\tau_u = 1 \text{ мкс}$) повышение температуры образца вследствие омического нагрева составляет $\Delta T = 0.3 \text{ К}$, а при $E = 250 \text{ В}/\text{см}$ $\Delta T = 2 \text{ К}$ при толщине образца 100 мкм.

Результаты эксперимента представлены на рис. 1. Видно, что с уменьшением толщины при $d < L_D$ (L_D — характерная диффузационная длина; для $n\text{-InSb}$ — $L_D = 150 \text{ мкм}$) су-

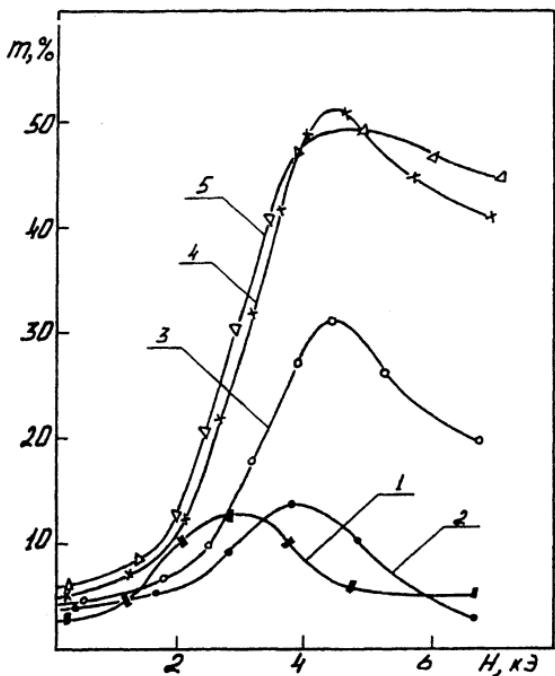


Рис. 2. Зависимость коэффициента модуляции СВЧ волны от напряженности внешнего магнитного поля ($d = 100$ мкм): 1 — $E = 100$ В/см, 2 — $E = 150$ В/см, 3 — $E = 185$ В/см, 4 — $E = 250$ В/см, 5 — $E = 300$ В/см.

щественно уменьшается m , что связано с диффузией носителей из области разогрева к поверхности и поверхностной рекомбинацией. Максимальная величина глубины модуляции в данном случае при $\lambda = 2$ мм составляет $\sim 90\%$, при $\lambda = 4$ мм $m \sim 70\%$, величина вносимых потерь $\alpha \simeq 3.5$ дБ ($\lambda = 2$ мм, $d = 100$ мкм). Подобное значение α в основном определялось отсутствием согласования для образца с $\epsilon = 17$, полностью перекрывающего волновод. Нанесение на полупроводник согласующих диэлектрических слоев, согласно оценкам [6], позволяет существенно (на порядок) понизить величину α .

Для изучения влияния магнитного поля на процесс модуляции на указанном принципе проводился эксперимент при $\lambda = 8$ мм для $n = 2.8 \cdot 10^{12}$ см $^{-3}$, $\mu = 5 \cdot 10^5$ см 2 /В · с, $\nu = 2.7 \cdot 10^{11}$ с $^{-1}$ и $\omega_p = 7.1 \cdot 10^{11}$ с $^{-1}$ (ν — частота релаксации по импульсу, ω_p — плазменная частота).

В эксперименте проводились измерения зависимостей прошедшей через образец мощности и коэффициента глубины модуляции электромагнитной волны импульсами электрического поля от значений приложенных электрических и магнитных полей. Результаты эксперимента представлены на рис. 2.

Кривые 1–5 иллюстрируют результаты измерения m (%) как функции внешнего электрического поля. Значительное возрастание m при $E > 200$ В/см (кривые 3–5) объясняется ростом отношения $\frac{\omega_p}{\nu}$ в результате развития ударной ионизации. В данном случае в тонких полупроводниках при $d < L_D$ плазменная частота существенным образом зависит от напряженности внешнего магнитного поля [1]. Магнитное поле (в геометрии Фарадея $H \parallel E \perp K$) позволяет компенсировать влияние поверхности на процесс ударной ионизации (ионизированная плазма при $d < L_D$ “отжимается” от поверхности полупроводниковой пластины, что эквивалентно увеличению во внешнем магнитном поле ω_p).

Проведенные исследования зависимости $m(H)$ в широком диапазоне изменения напряженности внешнего магнитного поля отражают основные физические закономерности взаимодействия коротковолнового излучения с замагниченной плазмой тонких полупроводников и полупроводниковых пленок. Как следует из приведенных на рис. 2 зависимостей, “выбор” соответствующих значений напряженности магнитного поля позволяет использовать в качестве эффективных модуляторов КВЧ диапазона тонкие полупроводниковые пленки с высоким значением глубины модуляции (в режиме ударной ионизации) и малым начальным ослаблением.

Верхний рабочий предел импульсной мощности подобных систем (в отличие от СВЧ диодов) ограничивается только средней рассеиваемой мощностью и может составлять десятки киловатт в импульсе.

Список литературы

- [1] Альтшулер Е.Ю., Кац Л.И., Чупис В.Н. // Радиотехника и электроника. 1992. № 7. С. 560–566.
- [2] Басс Ф.Г., Гуревич Ю.Г. Горячие электроны и сильные электромагнитные волны в плазме полупроводников и газового разряда. М.: Наука, 1975. 368 с.
- [3] Чупис В.Н., Черкасов В.Е., Калашников А.В., Царев В.П. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 21. С. 4–7.
- [4] Чупис В.Н., Косыгин О.А., Духовников Н.А., Семенова Е.М. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. В. 23. С. 69–73.
- [5] Владимиров В.В., Горшков В.И. // ЖЭТФ. 1976. № 4. В. 70. С. 1490–1495.
- [6] Гершензон Е.М., Литвак-Горская Л.Б. // Полупроводниковые приборы и их применение. Методы определения параметров полупроводников на СВЧ. М.: Сов. радио, 1970. 275 с.

Поступило в Редакцию
21 августа 1995 г.